



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: dmoreno@openskypr.com

EBEAM INITIATIVE 半导体业界精英调查预测：今年光光罩市场将持续增长

eBeam Initiative 欢迎 AGC 成为其最新成员

加州圣何塞，2025年9月23日——致力于教育和推广基于电子束（eBeam）技术的新型半导体制造方法的论坛组织“电子束倡议”（eBeam Initiative）今日宣布，其第十四届年度 eBeam Initiative 业界精英调查已完成。来自半导体生态系统中 51 家公司的行业专家——涵盖光罩、电子设计自动化（EDA）、芯片设计、设备、材料、制造和研究领域——参与了今年的调查。电子束倡议组织同时宣布，AGC 已作为其最新成员加入。

调查主要结论

参与调查的专家中有 64% 预测，2025 年的光罩（光掩膜）收入将较 2024 年有所增长，这一观点与 SEMI（国际半导体产业协会）预测的 2025 年同比增长 5% 相符(1)。在一个新的调查问题中，光罩刻写（mask writing）被列为 2026 年先进制程投资的首要任务，紧随其后的是光罩检测与修复（mask inspection and repair）以及光学邻近效应校正（OPC）/逆向光刻技术（ILT）。在一个相关的问题中，88% 的受访专家预测，未来三年内多电子束光罩刻写器（multi-beam mask writer）的采购量将会增加。

EUV 光刻技术和曲线光罩（curvilinear masks）是影响光罩市场的两个重要技术趋势。高数值孔径 EUV 光刻（High-NA EUV lithography）针对最先进的制程节点，目前正在开发中。在一个关于高数值孔径 EUV 对光罩制造商影响的问题中，40% 的专家现在认为所需的光罩亚分辨率辅助图形（SRAFs）的最小尺寸为 15 纳米或以下，高于去年的 29%。关于曲线光罩，业界对其制造能力的信心持续高涨，77% 的受访者表示，到明年年底，领先的光罩厂能够在大规模生产（HVM）中处理至少数量有限的曲线光罩。

此次行业专家调查的完整结果将于今晚在加州蒙特雷举行的 SPIE 光罩技术+ EUV 光刻会议期间的一场特别电子束倡议组织活动上，由一个专家小组进行介绍和讨论。活动结束后，调查结果可在 www.ebeam.org 网站下载。AGC 也将在此次活动上被确认为电子束倡议组织的最新成员，该组织现已拥有超过 50 家成员公司。

“我们非常高兴欢迎 AGC 加入电子束倡议组织，” 电子束倡议组织的管理公司赞助商 D2S 的首席执行官藤村先生 (Aki Fujimura) 表示，“光罩市场的持续增长凸显了光罩供应链的每一个环节对于半导体制造其他部分的重要性。作为光罩基板领域的领先供应商，AGC 带来了独特的视角，这将有助于加强我们提升行业认知和促进跨行业合作的共同努力。”



参考资料:

(1) Source: [Photomask Market Characterization Study](#), SEMI, August 8, 2025

关于 eBeam Initiative (电子束倡议团)

eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括: aBeam Technologies; Advantest; AGC; Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; ASML; Averroes.ai; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; FUJIFILM Corporation; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HJL Lithography; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMIT; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Tekscend Photomask; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH and ZEISS. eBeam Initiative 面向和欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###